

アクセス

Access



◆ 東武東上線でお越しの場合

東武東上線「東武練馬」駅下車
(徒歩約10分)

By Tobu Tojo Line

Approx. 10-minute walk from Tobu-nerima Sta.

◆ 東京メトロ有楽町線でお越しの場合

東京メトロ有楽町線/副都心線「地下鉄赤塚」駅下車
(徒歩約10分)

By Tokyo Metro Yurakucho Line / Tokyo Metro Fukutoshin Line

Approx. 10-minute walk from Chikatetsu-akatsuka Sta.



日本高純度化学株式会社

コーポレートガイド

Corporate Guide



JAPAN
PURE
CHEMICAL
CO.,LTD.



JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD.

電子部品向けめっき薬品 世界シェアトップ

当社は、1971年の設立以来、エレクトロニクス分野を事業フィールドの核に据え、半導体パッケージとコネクタ用の金めっき薬品、銀めっき薬品、パラジウムめっき薬品の開発・製造・販売を行ってまいりました。独自の研究開発体制によって、長年にわたり技術の集積を行ってきました。貴金属めっき市場で、技術・シェア・サービスとも世界で圧倒的優位を確保し、電子部品向けめっき薬品では世界トップシェアに位置しています。

Top Share in the Worldwide Market of Plating Chemicals for Electronic Components

Since its foundation in 1971, JPC has been developing, manufacturing and selling gold plating chemicals, silver plating chemicals and palladium plating chemicals for semiconductor packages and connectors, with a focus on the electronics field as our primary business domain. JPC has been amassing technologies over many years through our proprietary R&D systems. JPC has gained overwhelming superiority in the noble metal plating market with respect to technologies, market share and services, and has achieved the top share in the worldwide market of plating chemicals for electronic components.

当社めっき薬品を使用した電子部品

Electronic Components Using JPC's Plating Chemicals

Autocatalytic
palladium
Packages for smartphones

還元パラジウム
スマートフォン用
パッケージ

純金(99.99%以上)
ICパッケージの
ワイヤーボンド接続

Pure gold
(99.99% or more)
Wire bonding of IC packages

還元金
サーバーやデスクトップPC用
MPUパッケージ

Autocatalytic gold
MPU packages for servers and
desktop PCs

硬質金(Au-Co合金)
コネクタなどの
コンタクト接続

硬質金(Au-Co合金)
コネクタなどの
コンタクト接続

Hard gold
(alloy of Au-Co)
Contacts such as connectors

置換金
携帯基板のACF接続、
はんだ接続

Immersion gold
ACF connection and soldering of mobile substrates

電解パラジウム
リードフレームや
コネクタへの応用

Electrolytic palladium
Used for lead frames and connectors

企業理念

化学の好奇心でエレクトロニクスに役立てる
ファインケミカルとエレクトロニクスの架け橋となり、
独創的な製品でグローバルに社会貢献する

ビジョン

社会課題と向き合い、
多様な視点と独自の発想力を発揮し、
エレクトロニクス業界を牽引する
ファインケミカル企業となる

RDD2030:Redox技術を電池材料に!!

Team JPCで一丸となり、めっきで培った
酸化還元技術で付加価値を創造する

RDD2030

Redox-innovation through Discovery &
Development toward 2030

Corporate Philosophy

Contribute to electronics through curiosity about chemistry
As a linking bridge between fine chemicals and electronics, we
will contribute to society globally with our ingenious products.

Vision

Become a fine chemical company that leads the
electronics industry by addressing social issues and
exerting diverse perspectives and unique creativity

RDD2030 : Apply Redox technology to battery materials!

Unite as Team JPC, we will create added value with
the Redox technology cultivated through plating

RDD2030

Redox-innovation through Discovery &
Development toward 2030

トップメッセージ

Top Message

既存市場はもとより、新たな市場で評価される日本高純度化学へと進化



1971年の設立以来、日本高純度化学株式会社(JPC)はエレクトロニクス分野を事業
フィールドの核に捉え、半導体パッケージやコネクタ用途を中心に貴金属めっき薬品の
開発・製造・販売を行ってまいりました。

設立50年を過ぎた今、コロナ禍・DX化により急拡大する電子部品業界において、既存
市場以外においても自社の技術で解決できる社会課題があることが、より鮮明になってき
ました。

新規事業領域、市場ニーズを捉えて社会課題の解決につなげるべく、2030年までの
期間を3つのフェーズに分け、既存市場はもとより、新たな市場で評価される日本高純度
化学へと進化していくことを目指します。

開発型企業として、市場のニーズを収集し独創的な製品開発につなげることで、化学の
可能性に挑戦し続けてまいります。

何卒ご支援・ご愛顧のほど、宜しく願い申し上げます。

代表取締役社長 小島智敬

**We will evolve into the company that is valued not only in existing markets
but also in new markets.**

Since established in 1971, JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD. (JPC) has been developing, manufacturing and selling noble metal
plating chemicals, primarily for semiconductor packages and connectors, with a focus on the electronics field as our primary
business domain.

Today, 50 years after our establishment, in an electronic components industry that is rapidly expanding with the COVID-19
pandemic and shift toward DX, it has become clearer that our technologies can also provide solutions for social issues outside of
our existing markets.

With a view to grasping needs in new business domains and markets, and providing solutions to social issues, we aim to evolve
into the company that is appreciated in new markets as well as our existing ones, dividing the period through to 2030 into three
phases.

As a development-oriented company, we will continue to challenge the potential of chemistry by gathering information on market
needs and developing ingenious products.

Representative Director and President Tomoyuki Kojima

事業概要

Business Summary

当社は事業のターゲットを「最先端のエレクトロニクス業界の“貴金属めっき工程”というニッチな領域」に絞り込むことで、収益性の高いビジネスモデルを構築しています。製品開発からテクニカルサービスまで、トータルなソリューションを提案しています。



めっきの用途をエレクトロニクス分野に特化することにより、技術の深化、ニーズの先取りを行う

By specifically focusing on the electronics field in plating applications, we can better deepen the technologies and take customer needs in advance.

ビジネスモデル
Business Model

各部門を一堂に集めた体制を維持し、社内意思決定や顧客対応をスピーディーに行う

By operating an organization in which all divisions are together at one location, we can better make internal decisions and meet customer needs promptly.

めっき薬品の製造はフォーミュレーション業務に絞り、原材料などは外部から調達する方式で身軽な体質を維持

By focusing on formulation in the manufacturing processes of plating chemicals and using a system of procurement of raw materials etc. from external partners, we can maintain an agile business structure.

By narrowing our business targets to “noble metal plating processes” in the cutting-edge electronics industry, JPC has developed a highly profitable business model. JPC provides total solutions encompassing everything from product development to technical services.

当社製品を熟知し、エレクトロニクス業界全体、めっき技術全般についての最新動向を把握した営業部員が、長年の実績・ノウハウを活かし、マーケットの先行きを捉えながら、“提案型”で迅速に顧客に対応しています。

Our expert sales engineers, who keep abreast of the latest developments in the electronic industry and plating technologies, offer proposal-based responses to customer requirements promptly, in combination with decades of experience and know-how, and reading market trends.



With a slogan of “Speed, Accuracy and Safety,” we construct an efficient manufacturing system of short delivery times featuring flexible response to small-lot orders of a wide variety of items.

「高速・正確・安全」をスローガンに掲げ、多品種少量のオーダーについてもフレキシブルに対応する生産シフトで、短納期で出荷できる効率的な製造体制を整備しています。

エレクトロニクスと化学との橋渡し役を期待されている技術部門には、めっき技術を多様な切り口から解析する能力が必要とされます。様々な専門分野の人材を積極的に採用し、特徴ある技術集団で対応しています。

Our Technical Division bridges the gap between electronics and chemistry, incorporating analytical capabilities for diverse approaches to plating technologies. We actively recruit human resources from various areas of expertise, and approach challenges using our distinctive teams of engineers and technicians.

研究・開発

Research and Development

確かな技術開発力と
マーケティング戦略で、
進化するエレクトロニクス市場に対応

Superior Technological Development and
Marketing Strategy for Evolving Electronics Market



● 技術課題解決×環境配慮

電子デバイスの高密度化へのニーズがますます進展する中、当社は高解像度かつ省貴金属に寄与するめっき薬品を開発し、業界をリードしてまいりました。近年では業界に先駆けてMPUパッケージ用無電解金めっき薬品のシアンフリー化を達成しています。技術課題の解決と環境配慮志向の両面で新たな価値を提供しています。

Solving technical issues & considering the environment

As the demand for higher density electronic devices continues to grow, JPC has led the industry by developing plating chemicals that contribute to higher resolution and lower noble metal consumption. In recent years, we have been the first in the industry to achieve cyanide-free electroless gold plating chemicals for MPU packages. We provide new value in both solving technical issues and environmentally conscious aspects.

● めっき技術→電池材料へ

電気自動車や再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、従来よりも安価で軽量かつ長寿命な電池が求められています。電池の充放電反応は、めっきと同じ酸化還元反応（Redox反応）を利用しています。当社はめっき薬品開発で培ったRedox制御技術で電池材料の課題解決にも貢献すべく、新たな技術開発に着手しています。

Plating Technology to Battery Materials

As more electric vehicles and renewable energy are introduced, cheaper, lighter, and longer life batteries are required. The charge-discharge reaction of the battery uses the same redox reaction as that of plating. JPC has begun developing new technologies to help solve battery material issues with the Redox control technology we have cultivated through the development of plating chemicals.

技術サポート

Technical Support

多様な評価装置と
熟練の技術スタッフによる
きめ細やかなアフターフォロー

Comprehensive Follow-up Provided Through
Use of Various Evaluation Equipment and Skilled Technical Staff



● 少数精鋭の技術スタッフ

当社は少数精鋭の社員によって高い技術力を維持するために、優秀でロイヤリティの高い人材を確保し、めっきの職人技的な世界に科学的分析手法を導入して“Know-Why”を確立しています。また、広い見識と高いチャレンジ精神のもと、エレクトロニクス分野全体の更なる発展に寄与する人材を創出しています。

Selected Few Technical Staff

To maintain the high-level expertise by our selected few work force, JPC secures highly capable and loyal human resources, and not only nurtures the plating-related craftsmanship know-how but also establishes “Know-Why” by introducing scientific analysis methods. With a wide range of knowledge and an energetic spirit, JPC develops human resources that can contribute to further expansion of the overall electronics field.

● 多様な評価装置

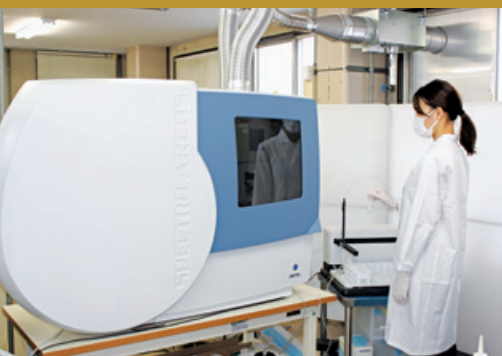
貴金属めっきが施される部分は、ますます小さくなっています。当社にはめっき皮膜の膜厚、表面や断面の高分解能観察はもとより、電気接点としての接続信頼性や電気抵抗性などの評価装置を揃えております。また、めっき薬品には様々な成分が含まれており、金属イオンだけでなく、様々な有機化合物の微量分析が可能です。

Various Evaluation Equipment

Surface areas that noble metal plating is being applied to are increasingly smaller. In this environment, JPC has evaluation equipment that assesses connection reliability and electrical resistance as electrical contacts, along with thickness of plated coatings, and high-resolution imaging of surface areas and cross sections. In addition, we are able to perform trace analysis for metallic ions and various organic compounds, with respect to the various ingredients in plating chemicals.

主要装置

Main Equipment



高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (SPECTRO ARCOS SOP130:日立ハイテクサイエンス)

めっき液などの溶液中の微量不純物の定量分析に使用します。高温プラズマ中で試料がイオン化されるので、共存元素の影響を受けにくく、ppm単位で定量できます。また、分析可能な元素が多いのも特徴です。

Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscope (ICP-OES)
(SPECTRO ARCOS SOP130: Hitachi High-Tech Science Corporation)
ICP-OES is used for the quantitative analysis of trace impurities in aqueous solutions (plating solutions, etc.). Many elements are analyzed quantitatively in the ppm range, as samples are ionized by high-temperature plasma and less affected by coexistent elements.



卓上型ワイヤーボンダー (HB16:TPTジャパン)

17～75μm径の金線・アルミ線・銅線を半導体部品に接続する装置です。ウェッジボンドとボールボンドの切替えが可能のため、多様な部品の試験に対応できます。

Desktop Wire Bonder (WB)
(HB16: TPT Japan Co., Ltd.)
Wire Bonder connects gold, aluminum and copper wires (17-75 μm diameter) to semiconductor components. A variety of components are evaluated by both wedge bonding and ball bonding.



高速液体クロマトグラフ (Prominence:島津製作所)

めっき液の不純物や成分の分析に使用します。めっき液を含む混合試料を固定相カラムに通液させることでカラムとの相互作用の違いにより各成分が分離されます。

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
(Prominence: SHIMADZU CORPORATION)
HPLC is used for the analysis of impurities and ingredients in plating solutions. By passing through mixed samples containing plating solutions, each ingredient is separated by interaction with stationary phase columns.



電界放出形走査電子顕微鏡 (S-4300:日立ハイテクノロジーズ)

試料表面の微細構造の観察に使用します。2次電子、反射電子の他、EDX検出器も搭載しています。貴金属めっきの数十ナノメートルオーダーの表面観察、集束イオンビームで加工しためっき断面の元素分析も可能です。

Field Emission-Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
(S-4300: Hitachi High-Technologies Corporation)
FE-SEM is used for observing fine structure of sample surfaces. Secondary electron, backscattered electron and EDX detectors are available. Observation of noble metal plating surface on the order of several tens of nanometers and cross sectional elemental analysis of plated coatings fabricated by focused ion beam (FIB) are also available.



万能型ボンドテスター (4000 Optima:ノードソン・アドバンスト・テクノロジー)

基板上に接合したはんだボールやボンディングワイヤーの接合強度・破断モード解析を行います。はんだボールは各種サイズに対応しており、プル試験・シェア試験が可能です。

Multipurpose Bondtester
(4000 Optima: Nordson Advanced Technology Japan K.K.)
Bondtester is used for analyzing bond strength and fracture mode of soldering balls and bonding wires on substrates. Various sizes of soldering balls are available both for pull and shear tests.



キャピラリー電気泳動分析装置 (P/ACE MDQ:エービー・サイエックス)

めっき液の不純物や成分の分析に使用します。めっき液を含む混合試料をキャピラリー管中で通電させることで、泳動速度の違いにより各成分が分離されます。

Capillary Electrophoresis Instrument (CE)
(P/ACE MDQ: K.K. AB Sciex Japan)
CE is used for the analysis of impurities and ingredients in plating solutions. By electrifying mixed samples containing plating solutions in a capillary tube, each ingredient is separated by the difference of migration speed.



オージェ電子分光分析装置 (PHI 4800:アルバックファイ)

試料最表面の数ナノメートルの元素分析に使用します。アルゴンスパッター装置を搭載しており、マイクロメートルレベルの深さ分析も可能で、下地金属の拡散や微量付着物の測定などに有効です。

Auger Electron Spectroscopy (AES)
(PHI 4800: ULVAC-PHI, Inc.)
AES is used for the elemental analysis of sample surfaces with depths of several nanometers. Further depth profile in the micrometer range is also available by argon sputtering. AES is effective for the measurements of the diffusion of underlying metal elements and trace foreign objects.



集束イオンビーム加工観察装置 (FB-2100:日立ハイテクノロジーズ)

イオンビームを利用して試料表面をエッチングし、試料を断面構造が観察可能な状態に加工する装置です。はんだボールとめっき面との界面に生成した合金層、ボイドなどの観察に使用されます。

Focused Ion Beam System (FIB)
(FB-2100: Hitachi High-Technologies Corporation)
FIB is used for fabricating a sample to a state that enables cross sectional observation by etching the sample surface with a focused ion beam. FIB is also used for the observation of interface structures (intermetallic compounds and voids) between soldering balls and plated coatings.

その他装置 Other Equipment

蛍光X線分析装置	X-ray Fluorescence Spectrometer
X線回折装置	X-ray Diffractometer
リフローはんだ付け装置	Reflow Soldering Equipment

紫外可視分光光度計	Ultraviolet-visible Spectrophotometer
フーリエ変換赤外分光光度計	Fourier Transform Infrared Spectrophotometer
微小硬度計	Micro Hardness Tester

電気接点シミュレーター	Electrical Contact Resistance Tester
ガス腐食試験機	Gas Corrosion Test Instrument
塩水噴霧試験機	Salt Spray Test Instrument

原材料の調達から廃棄にいたるまで、 事業のあらゆる過程で製造業の社会的責任を果たす

Fulfill Social Responsibility as a Manufacturing Company in Every Process of the Business from Procurement of Raw Materials to Disposal

当社は貴金属や希少鉱物を使用する製造業であり、また多くの化学物質を使用するという事業の特質上、地球環境への配慮が不可欠です。資源を有効利用し、地球環境を保全し持続可能な社会づくりに貢献することを前提として事業活動を行い、環境負荷を継続的に低減していきます。

Because we are a chemical manufacturer which uses noble metals and rare minerals and deals with many kinds of chemical substances, environmental consideration is a matter of high concern. Based on the premise that we must effectively utilize natural resources, preserve the global environment and contribute to sustainable society, we will conduct business activities and continuously reduce the environmental burden.

紛争鉱物に対する基本方針

貴金属めっきで使用される金はコンゴ民主共和国及び周辺諸国で人権侵害、環境破壊など、不正に関わる組織の資金源となっている紛争鉱物にも指定されています。当社はこのような紛争鉱物を調達しないことを基本方針とし、取引先と連携をとり、サプライチェーンの透明性の維持に努めております。

Basic Policy for Conflict Minerals

Gold has been specified as a conflict mineral due to its use as a source of funding for organizations involved in wrongdoing, such as human rights abuses and environmental destruction in the Democratic Republic of the Congo and the neighboring countries. We have established a basic policy of not procuring conflict minerals originating from these countries and we are cooperating with business partners to keep the transparency of the supply chain.



廃液を徹底管理し、循環型社会の一翼を担う

貴金属めっきの実験・製造などの過程で発生した廃液は、貴金属の種類で分別し、低濃度の廃液は排水処理設備で処理しています。排水処理設備では、中和、ろ過、イオン交換などが行われ、有害イオンなどが検出されない状態で下水に排水しています。また、貴金属めっきの廃液は外部委託業者によって精製され、貴金属の再利用を行っています。

Control Effluents Thoroughly and Contribute to a Recycling Society

We sort effluents discharged in the processes of experiments and manufacturing on noble metal plating by the type of noble metals. The low content effluents are neutralized, filtrated and ion exchanged by the wastewater treatment facilities. The treated water discharged to sewage does not contain any detectable traces of hazardous ions etc. We also make use of outside contractors who refine noble metal plating effluents in order to reuse noble metals.

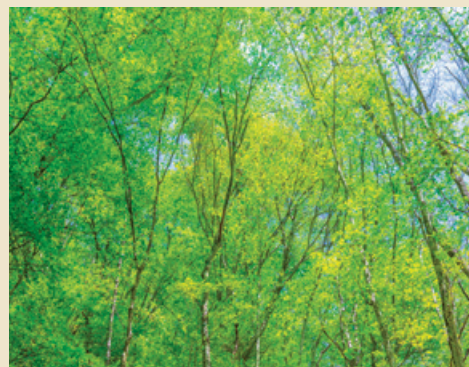


公益財団法人JPC奨学財団

当社は未来を担う高い志と学業意欲がありながら、経済的理由により修学困難な学生を奨学支援する公益財団法人JPC奨学財団の運営を行っています。革新的な技術、学術の発展に寄与する人材、グローバルな視野をもった人材を育成することを通じて、微力ながら社会の発展に貢献してまいります。

JPC Scholarship Foundation

JPC operates the JPC Scholarship Foundation (public interest incorporated foundation), which supports students who have difficulties learning due to economic reasons while having high aspirations for the future and the desire to perform in school. We will do our best to contribute to the development of society by fostering talent who will contribute to the development of innovative technologies and science, as well as hold a global point of view.

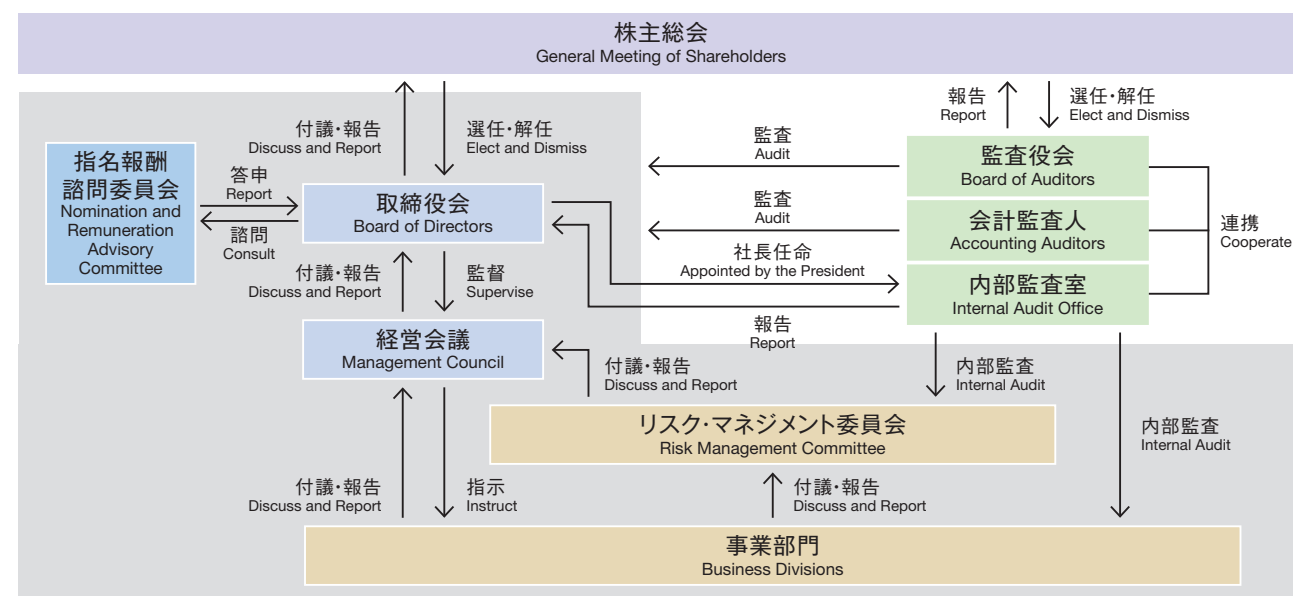


基本原則への対応方針

Policy on the General Principles of the Corporate Governance Code

- 株主の権利・平等性の確保**
 招集通知の早期発送や情報の充実など株主の皆様の実質的な平等性を確保すべく、十分に配慮を行っております。
Securing the Rights and Equality of Shareholders
 We adequately consider the matter of securing effective equality of all our shareholders by making earlier delivery of convocation notices and providing them with substantial information.
- 株主以外のステークホルダーとの適切な協働**
 顧客・従業員・取引先・地域社会などの株主の皆様以外のステークホルダーとの長期持続的で良好な関係を構築・維持し、共栄を図ってまいります。
Appropriate Cooperation with Stakeholders Other Than Shareholders
 We strive to build and maintain longstanding and positive relationships with our customers, employees, business partners, communities and stakeholders other than our shareholders.
- 適切な情報開示と透明性の確保**
 法定開示以外にも重要と判断される情報は、当社ホームページや会社説明会などの様々な手段により積極的に開示を行っております。
Ensure Appropriate Information Disclosure and Transparency
 We actively disclose information deemed important, even if not subject to statutory disclosure, through various channels such as the JPC corporate website and our company briefing sessions.
- 取締役会等の責務**
 社外取締役を3名にしており取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、監査役4名は全員社外監査役を選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。加えて、取締役の任期は1年とし、評価が適時に行われ、その責務を適切に果たされるよう環境を整備してまいります。
Responsibilities of the Board of Directors
 We have established a highly effective system for carrying out supervision of directors by appointing three outside directors. We have also established a highly independent system for carrying out audits of directors in their execution of duties by appointing four outside auditors. In addition, we have maintained an environment that enables directors to fulfill their responsibilities appropriately, where directors serve for one-year terms and are evaluated in a timely manner.
- 株主との対話**
 IR担当取締役を中心とするIR体制を整備し、会社説明会、スモールミーティング、電話取材など、様々な形で株主の皆様を含むステークホルダーと経営トップとコミュニケーションを行っております。
Dialogue with Shareholders
 We have established an investor relations framework centered on the director in charge of investor relations. Moreover, the members of top management engage in communication with our shareholders and other stakeholders through various channels and formats that include company briefing sessions, small meetings, and telephone interviews.

会社の機関・内部統制の関係図 Organization and Internal Control System of the Company



沿革

History

貴金属めっき薬品の開発、製造及び販売を 目的として日本高純度化学株式会社を設立 (資本金1,000千円)	1971年 7月 (昭和46年) July, 1971	Establishment of JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD. for the development, manufacture and sales of noble metal plating chemicals (capitalization of ¥1,000,000)
半導体用軟質金めっき薬品開発	1972年 2月 (昭和47年) February, 1972	Development of soft gold plating chemicals for semiconductors
コネクタ・プリント配線板用硬質 金めっき薬品開発	1974年 4月 (昭和49年) April, 1974	Development of hard gold plating chemicals for connectors and printed circuit boards
コネクタ用電解パラジウムめっき薬品開発	1985年 9月 (昭和60年) September, 1985	Development of electrolytic palladium plating chemicals for connectors
MBOを実施	1999年11月 (平成11年) November, 1999	Implementation of MBO
フレキシブル基板用電解軟質金めっき薬品と 銅除去薬品開発	2001年 3月 (平成13年) March, 2001	Development of soft gold plating chemicals used in flexible boards and copper removal chemicals
JASDAQ市場に上場 資本金を1,134,000千円に増資	2002年12月 (平成14年) December, 2002	JASDAQ market listing Capitalization increased to ¥1,134,000,000
高速MPU用還元金めっき薬品開発	2003年 5月 (平成15年) May, 2003	Development of autocatalytic gold plating chemicals used in high-speed MPUs
東京証券取引所市場第二部に上場	2004年 3月 (平成16年) March, 2004	Listing on TSE Second Section
1株を2株に株式分割	2004年 5月 (平成16年) May, 2004	2 for 1 stock split
東京証券取引所市場第一部に上場	2005年 3月 (平成17年) March, 2005	Listing on TSE First Section
ISO9001、ISO14001を同時認証取得	2005年 4月 (平成17年) April, 2005	Achievement of ISO 9001 and ISO 14001 certification
東京大学と実装技術に関する共同研究開始	2005年11月 (平成17年) November, 2005	Initiation of joint research into mounting technologies with the University of Tokyo
1株を2株に株式分割	2006年 4月 (平成18年) April, 2006	2 for 1 stock split
携帯電話マザーボード用置換金めっき薬品開発	2007年 3月 (平成19年) March, 2007	Development of immersion gold plating chemicals used in mobile phone motherboards
微細コネクタ用硬質金めっき薬品開発	2008年 7月 (平成20年) July, 2008	Development of hard gold plating chemicals used in fine connectors
1株を100株に株式分割	2014年 4月 (平成26年) April, 2014	100 for 1 stock split
一般財団法人JPC奨学財団を設立 (2020年4月より「公益財団法人」)	2019年 2月 (平成31年) February, 2019	Establishment of JPC Scholarship Foundation (public interest incorporated foundation from April, 2020)
東京証券取引所プライム市場に移行	2022年 4月 (令和4年) April, 2022	Move to the Prime market on TSE

会社情報

Corporate Information

● 社 名	日本高純度化学株式会社	● Name	JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD.
● 設 立	1971 (昭和46) 年7月16日	● Established	July 16, 1971
● 所 在 地	〒179-0081 東京都練馬区北町三丁目10番18号	● Address	3-10-18 Kitamachi, Nerima-ku, Tokyo 179-0081, Japan
● T E L	03-3550-1048	● TEL	+81-3-3550-1048
● F A X	03-3550-1006	● FAX	+81-3-3550-1006
● お問い合わせ窓口	・営業関連 営業部 TEL 03-3550-1048 ・IR関連 経営企画部 TEL 03-3550-1048	● For inquiries	About Sales Marketing Division TEL +81-3-3550-1048 About IR Corporate Planning Division TEL +81-3-3550-1048
● 資 本 金	12億83百万円	● Paid-in capital	¥1,283 million
● 従業員数	44名	● Number of employees	44 persons
● 主要業務	電子部品用貴金属めっき薬品の 開発・製造及び販売	● Main business	Development, manufacture and sales of noble metal plating chemicals for electronic components
	(2022年3月31日現在)		(As of March 31, 2022)